株式会社 新　川
ニュースリリース

2013 年 5 月 27 日

TCB 工法ウェーハ用フリップチップボンダ LFB-2301 受注開始

株式会社新川（社長：西村浩、東京都武蔵村山市伊奈平二丁目 51 番地の 1）は、フリップチップボンダ LFB シリーズの新製品として、TSV デバイスなどに対応した NCF-TCB（*1）工法ウェーハ用（C2W *2）機種「LFB-2301」の開発を完了し、受注を開始しました。
同機種は、LFB シリーズのキーテクノロジーである精細な Z 荷重コントロールに加え、異種チップボンディング機能の搭載により、2.5D、3D 積層パッケージングに対応するとともに、高速パルスヒータを用いた短時間加熱・冷却により、高スループットを実現できます。

【LFB-2301 の特長】

(1) 品種自動交換機能により、4 品種までの異種チップボンディングに対応
(2) ボンドヘッド Z 軸は、高精度な荷重制御、位置制御を両立
(3) 高速パルスヒータを用いた短時間加熱・冷却による高スループット
(4) 薄ダイピックアップに対応
(5) 安定した品質を確保するための、プロセスモニタリングによるトレーサビリティ
(6) オプションにより Flux-TCB プロセスにも対応

【フリップチップボンダ LFB-2301】

LFBシリーズでは、モジュラー方式の採用により、2ボンディングヘッドタイプも対応可能です。2ヘッドタイプにすることで、省スペースと生産性の向上に寄与します。

*1 TCB ： Thermal Compression Bonding
*2 C2W ： Chip to Wafer

■ その他当社取扱製品
ワイヤボンダ、ダイボンダ、バンプボンダ等

■ お問合せ先
お客様お問合せ担当：フリップチップ営業部 北林 靖基 ・ 安藤 秀彦（TEL：042-560-1225）
報道機関お問合せ担当：経営企画部 森 琢也（TEL：042-560-4848）

以上

株式会社 新　川
〒208-8585　東京都武蔵村山市伊奈平 2-51-1